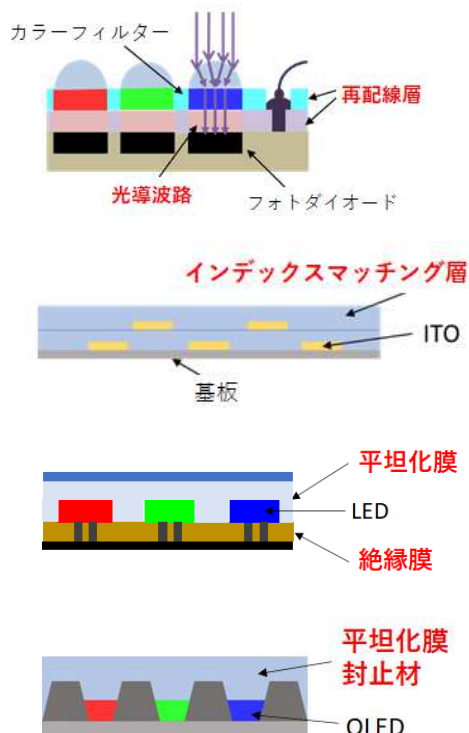


用途

- ✓ 光学デバイス
イメージセンサー
タッチセンサー
μ-LED/OLEDディスプレイ
- ✓ 低耐熱性デバイス

特長

- ✓ フッ素含有アクリル樹脂組成物
- ✓ 低屈折率
- ✓ フィラー無添加
- ✓ 厚膜パターンニング可能
- ✓ 低温硬化
- ✓ 高密着性



	膜厚	屈折率 @633nm	透過率 @380-800nm	硬化温度	適用可能基材
CELIMS™	~30μm	1.4	>95%@1μm	110°C	Si, Glass, PET, PI

パターン形状

L/S=10μm/10μm
Thickness: 20μm

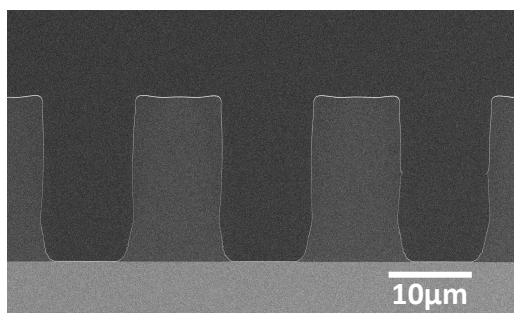


Image of SEM Measurement

L/S=10μm/10μm
Thickness: 20μm

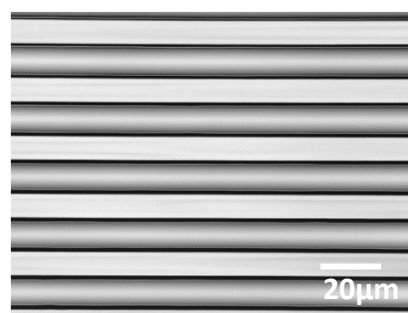


Image of Laser microscope

